

組立後の洗浄工程削減へ！

Eliminate cleaning process after assembly!

フラックス残渣レス溶ダペースト

Less flux residue solder paste

NP303-FLV-T4

フラックス残渣が残らず**洗浄不要**！

Since flux residue does not remain, cleaning is unnecessary!

Niなどのヌレにくい母材に対しても**ヌレ性良好**！

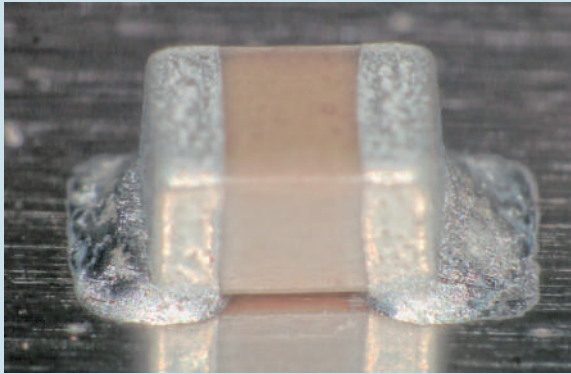
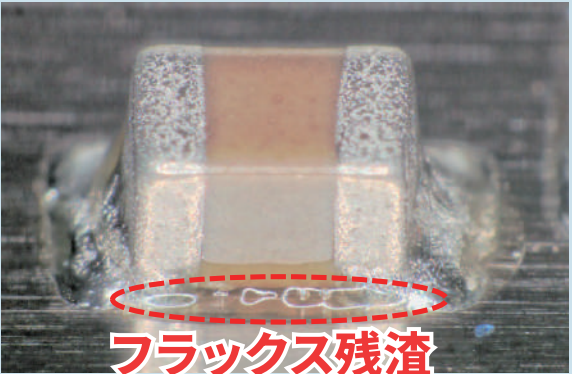
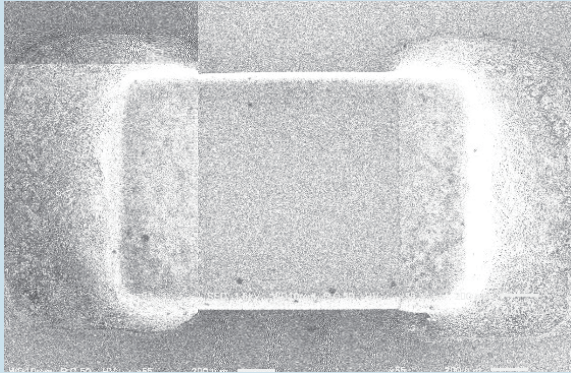
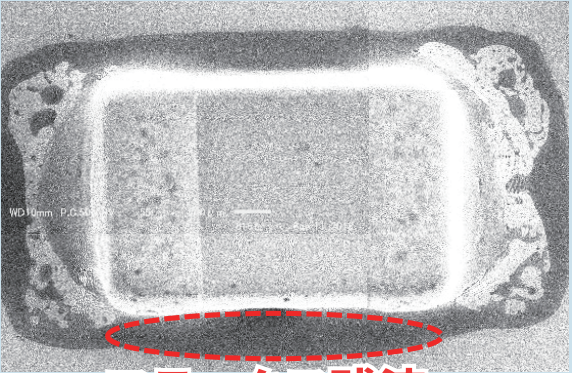
Wettability to the parts that are hard to be wet like Ni are also good!

N2 + 真空リフロー対応で**ボイド発生を抑制**！

Suppress occurrence of void by N2 + vacuum reflow furnace!

揮発によるフラックス残渣抑制

Suppression of flux residue by volatilization

	残渣レス溶ダペースト Less flux residue solder paste	一般溶ダペースト Normal solder paste
2125C		
2125C SEM		

ギ酸リフロー対応、 フラックス残渣レス溶ダペースト

Less flux residue solder paste applied for formic acid reflow

NP303-FL001-T4

ギ酸リフローにより**フラックス残渣、ボイドゼロ**！

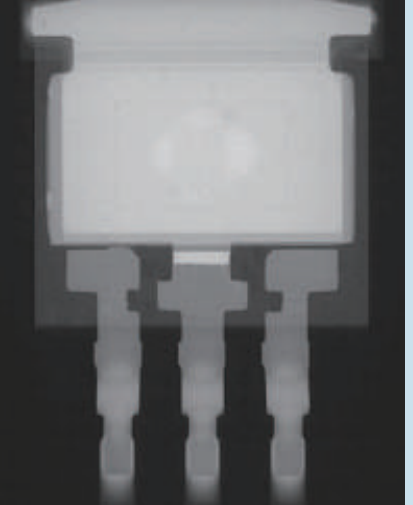
No flux residue and void due to formic acid reflow!

微細はんだ粉末適用により**微小接合が可能**！

Fine solder powder-applied products enable micro-joints!

ギ酸リフロー性の検証結果

Test result of reflowability for formic acid reflow

外観写真 Exterior photograph	X線透過写真 X-ray transmission photograph	Cu板濡れ写真 Cu plate wetting photograph
		
ぬれ性良好 Good wettability フラックスの残留無 No flux residue	ボイド無 No void	フラックスの残留無 No flux residue

残渣レスフラックス Ultra-low residue flux

RLF001

洗浄工程を削減可能！

Cleaning process can be eliminated

N2リフロー対応可能！

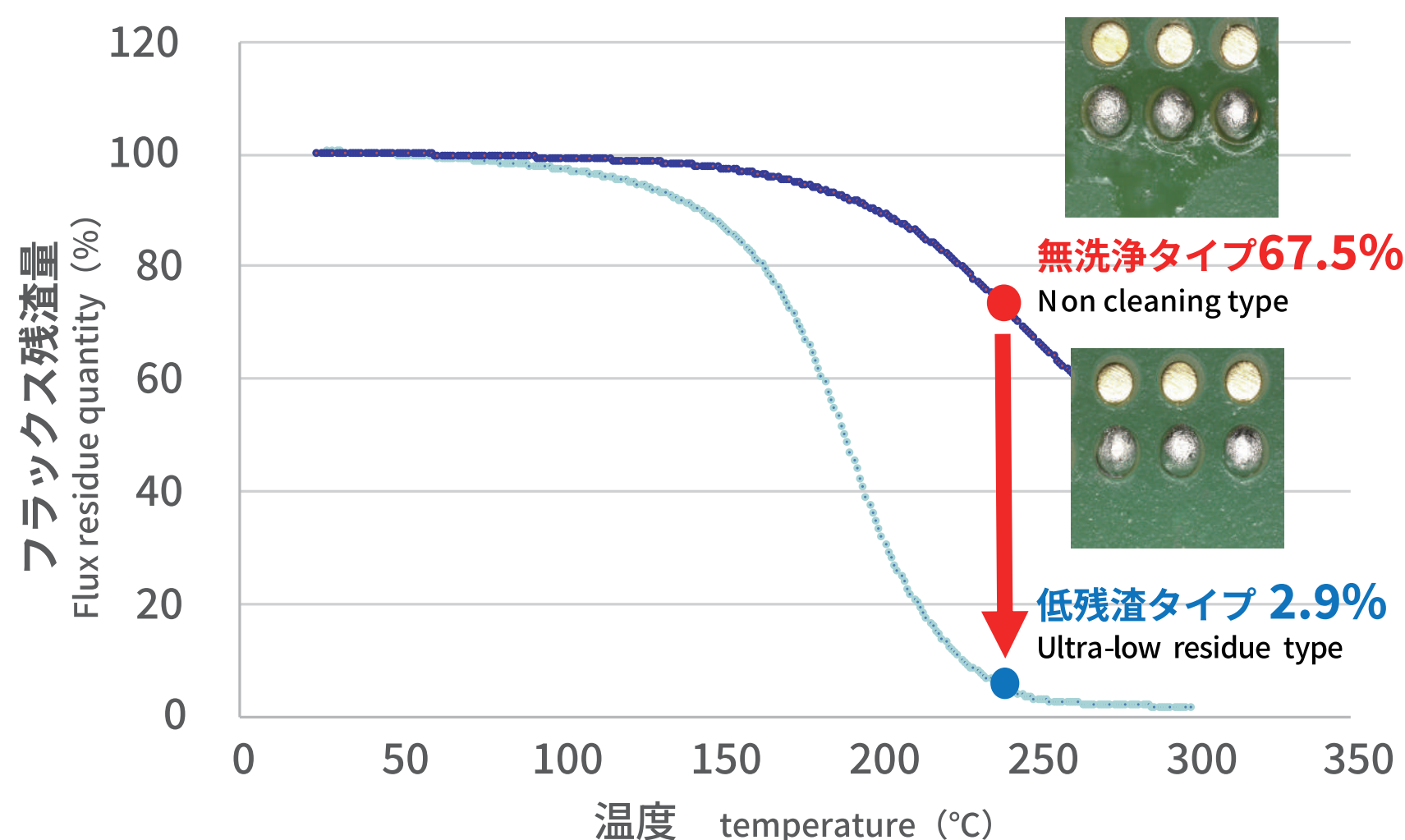
Applicable to N2 reflow

はんだバンプに対応！

Applicable to solder bumps

洗浄工程を削減

Eliminate cleaning process

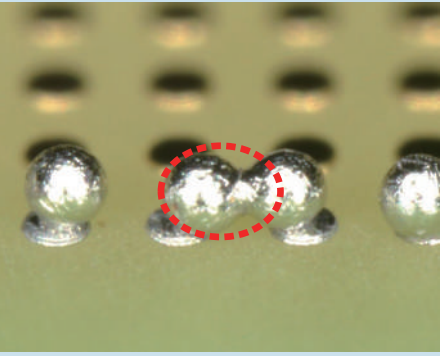
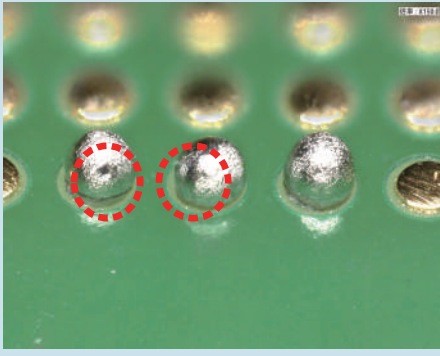


フラックス残渣量を大幅に低減！

Significantly reduced flux residue

はんだバンプ対応

Applicable to solder bumps

特徴 Features	隣接ボールと接 合せず、ボール が保持 Balls are not joined with adjacent balls and are retained	ボール表面に窪 みが無く、均一 で滑らか Uniform and smooth with no depressions on the ball surface	安定した溶融で、 溶融後のボール 高さが均一 Stable melting, uniform ball height after melting
一般フラックス Normal flux			
残渣レスフラックス Ultra-low residue flux	